公司代码:688620 公司简称:安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币-6,684.15万元。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安凯微	688620	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李理鹏	曾丽英
联系地址	广州市黄埔区博文路107号	广州市黄埔区博文路107号
电话	020-32219000	020-32219000
传真	020-32219268	020-32219268
电子信箱	ir@anyka.com	ir@anyka.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(一)主营业务

公司是一家芯片设计企业,设计并销售赋能AI硬件的AI SoC芯片。公司产品已构建覆盖智能视觉、音频交互、短距离通信、电源管理等领域的全链路AI硬件芯片矩阵,广泛应用于智能家居、智能穿戴、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。典型终端应用包括家用摄像机、安防摄像机、婴儿监视器、AI眼镜、运动相机、AI桌面机器人、智能玩具、智能手表/手环、智能头盔、楼宇可视对讲、智能门禁/考勤设备、智能门锁、智能中控屏、工业显示终端、网关、智能录音笔、AI耳机、智能音箱等。报告期内,公司带算力芯片累计出货量超过一半,全面赋能新一代智能设备的感知、交互与计算能力。

(二)主要产品及服务

公司主要芯片产品属SoC芯片(系统级芯片),SoC芯片集成度高、架构复杂,是各类电子终端设备进行运算处理及整机控制的核心部件,决定了终端产品的性能边界与智能化水平。

报告期内,公司抓住人工智能技术在端侧和边缘侧发展的产业机遇,以“视觉+语音+传感”的多模态感知融合和智能处理能力为核心,不断拓宽应用场景边界,构建覆盖智能家居、工业视觉、安防监控、智能穿戴等领域的多元化产品应用生态。

目前,公司已量产或推出多款AI SoC芯片,包括物联网摄像机芯片、低功耗蓝牙芯片、人机交互芯片及电源管理芯片等,形成了覆盖硬件、算法与系统集成的“全栈式”解决方案。产品布局不仅夯实了公司的技术与市场基础,更持续为客户打造融合音频、视频、语音、图像、图形等多模态感知能力的智能体验,为AI硬件提供核心技术支撑。

1.物联网摄像机芯片

报告期内,公司物联网摄像机芯片产品线是公司业绩增长的重要驱动力。2025年,物联网摄像机芯片出货量稳步提升,AK39AV130系列(多目低功耗)、KM01系列(AOV超低功耗)与KM02系列(边缘算力型)协同发力,覆盖从轻量级至边缘计算的算力需求,可满足不同应用场景对智能处理能力的差异化要求。产品全面支持暗光黑光成像、高清视频采集与编码,为多目协同、全天候录像、端侧AI检测识别等应用提供完整的芯片级解决方案,产品应用从智能安防向智能穿戴、AI桌面机器人等新兴场景持续拓展,其中AI眼镜芯片已量产出货。KM01荣获第二十届“中国芯”优秀市场表现产品奖,产品市场竞争力获得行业认可。

(1)AK39AV130系列多目低功耗智能摄像机芯片

该系列采用双核CPU架构,集成NPU,最多可接入4路摄像头并实现多路同步协同,支持AOV低功耗技术,1秒1帧模式下单目整机平均功耗低于30mW。多目低功耗协同处理能力以极低功耗代价实现多目同步采集与处理,为大范围、无死角智能监控场景提供芯片级解决方案。该系列主要面向多目智能摄像机、枪球联动系统等专业安防领域,适用于对功耗有严格要求的商业与家庭安防场景。

(2)KM01系列AOV低功耗智能视觉芯片

该系列是公司面向智能家居、智慧安防、智能穿戴、工业视觉等高增长赛道推出的高集成度端侧AI视觉处理芯片。芯片支持最高5MP@20fps视频编码,拍照分辨率达12MP,AOV模式下整机功耗低于30mW(1秒1帧),有效解决续航痛点;支持四路CIS接入与16倍数字变焦,具备安全启动功能。KM01A采用小型化封装,专攻低功耗AOV摄像机、4G太阳能球机、猫眼锁、可视门铃等场景;KM01W集成Wi-Fi 6/BLE,为AI眼镜提供“芯片级低功耗+高清画质”配套开发平台,满足智能穿戴对小体积、低功耗、高集成度的严苛需求。KM01荣获第二十届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

(3)KM02系列边缘算力型智能视觉芯片

KM02G专为AI拍照眼镜、运动相机定制,采用双核64位RISC-V架构,内置NPU与DDR3L,集成安凯微第五代ISP及自研IPU,支持畸变校正与防抖算法,实现超高清图像处理与多模态传感输入,具有尺寸小、性能高的特点。KM02X具备边缘算力,支持4K视频采集与高清显示输出;音频方面支持多路麦克风阵列、声源定位、环境降噪及语音唤醒,打造全场景音视频交互闭环。基于KM02X的边缘计算万物识别解决方案,集成本地化视觉大模型技术,实现离线环境精准物体识别。KM02X应用场景覆盖智能带屏摄像机、AI儿童相机、智能闹钟、会议系统,并拓展至AI玩具、智能中控屏等人机交互类场景。

公司已具备在智能视觉领域持续迭代的市场和能力,后续支持更高算力、更低功耗的芯片已在研发设计中,将进一步巩固在智能家居、智能安防、智能穿戴、行业应用等领域的市场竞争力。

2.低功耗蓝牙芯片

公司低功耗蓝牙芯片已在智能门锁、智能音频设备、导教及玩具类终端产品中实现规模化应用。

蓝牙音频芯片AK1080系列主要面向AI耳机(含TWS与OWS)、AI头盔、蓝牙双模遥传等应用场景。该芯片内置32-bit RISC-V内核;具备超低功耗、A2DP音乐播放模式下(中等音量),整机功耗低至4mA,显著延长终端设备续航;支持经典蓝牙(BR/EDR)与低功耗蓝牙(BLE)同时工作,满足复杂场景下的无线连接需求;内置24bit DAC,在低电压音频输入下仍能输出高信噪比音频信号;支持16段EQ调节,便于厂商根据不同应用灵活定制音效;具有广泛兼容性,已完成与200余款主流品牌手机的兼容性适配,确保稳定连接与用户体验。

AnyBlue1080 PDK(产品开发包)提供完整的平台化开发工具与资源。

AK1090系列蓝牙音频芯片在AK1080基础上,集成了自主研发的双麦克风AI环境降噪(ENC)模块,并在保持低功耗的同时,针对OWS耳机、AI眼镜等智能穿戴设备进行了系统优化。AK1090不但完善了公司在智能音频领域的布局,还与公司KM01W、KM02G等视觉芯片协同,形成覆盖AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI投影眼镜等全系列智能眼镜解决方案。在公司AOV2(Always On Video)超低功耗监控方案中,AK1090与KM01A/W芯片组搭配,实现了设备端视频与语音的“始终在线”能力。

报告期内公司发布收购思澈科技85.79%股权公告。思澈科技是一家专注于创新型高性能、超低功耗物联网MCU的芯片设计公司,以智能穿戴设备为核心场景,提供集成蓝牙通信、图形引擎的超低功耗异构物联网平台芯片解决方案。

思澈科技SF32LB系列芯片是专为智能手表、智能手环、AI眼镜等穿戴设备打造的高性能、超低功耗物联网主控芯片,采用异构双核处理器架构;在典型使用场景下,蓝牙1s间隔连接模式平均功耗仅5.6-9.5μA,BLE连接模式下200ms间隔功耗23μA,500ms间隔低至10μA,显著延长穿戴设备续航时间;集成自主研发的ePicasso 2D/2.5D GPU,支持四图层叠加,alpha混叠及硬件加速的实时旋转与缩放,叠图效率达1 cycle/pixel,配合无损压缩解码引擎,可实现480x480分辨率下24位色60fps的高流畅度显示,满足智能穿戴设备对图形界面的严苛需求;支持蓝牙5.2/5.3双模,低功耗蓝牙接收灵敏度达-100dBm(1Mbps),全面支持125k/500k/1M/2Mbps多种速率模式,确保复杂环境下连接的稳定性;内置最高3.7MB SRAM并合封PSRAM和Flash;部分型号集成PMIC电源管理单元,创新的外设任务控制器无需唤醒CPU即可自动完成外设调度,大幅减少BOM成本与PCB面积。

思澈科技项目收购完成后,公司在蓝牙芯片领域形成“音频+连接+图形”的完整技术拼图:公司自主研发的AK1080/AK1090系列专注于高保真音频处理与AI环境降噪,而思澈科技的SF32LB系列则以异构双核架构和自研2.5D GPU为核心,在智能手表、智能手环等穿戴设备上实现480x480分辨率60fps流畅显示的同时,将蓝牙连接功耗控制在9.5μA量级。母子公司产品协同,使公司能够为AI音频眼镜、智能手表、智能手环等终端提供从语音交互、无线连接到图形显示的一站式解决方案,真正实现终端设备“能听会说、可见可显”的全方位智能体验。

3.人机交互芯片

公司HMI人机交互芯片已广泛应用于智能门禁考勤、智能门锁、楼宇可视对讲、工业显控屏等终端产品。报告期内,公司依托在智能处理、低功耗及显示等领域的技术积累,持续推动人机交互芯片向更多元化应用场景拓展。

AK2659视觉处理芯片作为人机交互领域的关键组件,集成双核960MHz CPU、1TOPS NPU、自研ISP及DPU(智能处理单元),支持人脸识别、掌静脉识别、手势识别及人形跟踪等功能,能够满足智能门禁考勤、智能中控屏等场景对本地化智能处理的较高要求。AK2659芯片的手势识别与人形跟踪能力还能与公司AK1037芯片结合实现灵动屏与马达控制,展现在交互式机器人中的应用潜力。目前,该方案已有多个客户项目处于开发阶段。基于KM02X芯片的高清带屏智能视觉方案具备4K视频采集能力,配置端侧AI算力,可支持多种识别算法,已广泛应用于智能闹机、会议系统等专业领域,并向人机交互类场景持续延伸,逐步进入智能中控屏、AI玩具、智能白电等新兴领域。

4.电源管理芯片

AK5301芯片是公司2025年发布的一款光伏充电管理器件,支持太阳能、USB、AC适配器等多种输入源,实现高效能源管理。该芯片通过MPPT算法动态优化光伏板输出,最大化能量采集效率;支持动态电源管理(DPPM),可智能调节输入电流,防止过载,提升系统稳定性;其超低静态电流设计在船运模式下低至2μA @4.2V,空载时仅25μA,显著延长设备续航;芯片集成过压保护、过流保护、短路保护等多重安全机制,并支持JEITA/GB 31241-2022充电安全标准,提供完备的电池充放电管理,确保系统安全可靠运行。

AK5301可广泛应用于户外摄像机、智能穿戴、便携医疗、应急照明及物联网终端等低功耗、高可靠性场景,是公司在绿色能源与智能终端融合领域的关键产品,助力绿色智能设备的普及与升级。该芯片与公司KM01系列AOV超低功耗监控方案协同,可构建“太阳能供电+低功耗联接”的无线户外摄像机系统,实现图充图用、长续航、高稳定运行。

5.智能门锁解决方案

报告期内,公司的智能门锁“全栈式”解决方案初见成效,相关产品线开始逐步贡献业绩。该方案覆盖锁控、猫眼、显控、人脸识别四大核心模块,可为客户提供从芯片到模组的完整支持,助力终端厂商降低开发门槛、缩短产品上市周期。

报告期内,公司正式推出的专为智能门锁设计的AK1037低功耗锁控SoC芯片采用RISC-V内核,集成指纹识别加速、RFID卡识别、BLE、触摸按键、语音播报等核心功能,具有高集成度、低功耗等特点。

经过持续布局,公司已构建覆盖智能门锁核心环节的完整芯片产品矩阵:

芯片类别	代表产品	核心功能	应用场景
锁控芯片	AK1037	指纹识别、RFID、触摸按键、语音播报、BLE连接	智能锁主控,门禁考勤、控制面板
猫眼芯片	KM01A	低功耗AOV视频监控、图像采集	智能猫眼,可视门铃
显控芯片	KM02X	高清显示输出,人机交互界面	智能锁显示屏,智能中控屏
人脸/掌静脉识别芯片	AK2659	1TOPS NPU,人脸/掌静脉识别,人形跟踪	高端智能锁,考勤机

客户可根据不同定位的智能锁产品需求,灵活选择单颗或多颗芯片组合,实现从基础锁控到高端视觉识别的差异化功能配置。

公司智能门锁芯片已与凯迪仕、德施曼、浙江公牛、乐橙等行业知名品牌建立合作。AK1037还可扩展应用于智能门禁考勤、家电控制面板及充电桩等终端。报告期内,多个客户基于AK1037芯片立项开发,预计将陆续量产出货。

6.智能眼镜解决方案

公司智能眼镜解决方案已形成覆盖AI音频眼镜、AI拍摄眼镜、AI显示/投影眼镜等主流品类的完整芯片矩阵,报告期内部分AI眼镜SoC芯片已经实现量产。其中,KM01W作为中端AI眼镜核心SoC芯片,集成双频Wi-Fi 6与蓝牙5.4,支持AOV超低功耗模式,专为轻量化智能眼镜提供芯片级“低功耗+高清画质”配套开发平台;KM02G作为高端AI拍照眼镜定制芯片,采用双核64位RISC-V架构,内置1TOPS NPU与1Gbit DDR3L,集成自研ISP及IPU,支持畸变校正与防抖算法,实现超高清图像处理;AK1090蓝牙音频芯片支持蓝牙双模,集成自研双MIC AI环境降噪模块,实现蓝牙音频传输与降噪处理,采用低功耗设计可适配AI眼镜、OWS耳机等穿戴设备。

功耗表现方面,基于公司方案的单次拍照介合电池容量消耗可低至0.02mAh,连续录像60秒折合电池容量消耗可低至254mAh,为智能眼镜长续航体验提供坚实保障。

思澈科技加入后,AI眼镜解决方案的显示交互能力提升,功耗下限更低。上述各种芯片产品组合能够为AI音频眼镜、智能手表、智能手环等终端提供从语音交互、无线连接到图形显示的一站式低功耗解决方案,真正实现终端设备“能听会说、可见可显”的全方位智能体验。

7.多模态智能终端解决方案加速落地

公司以自研SoC芯片为核心,顺应AI应用的发展趋势,推出面向AI硬件的多样化终端解决方案。

智能带屏摄像机方案支持视频/图片双向内容交互及“AI语音+智能安防”功能,可应用于智能家居、智能监控等领域。边缘计算万物识别解决方案集成本地化视觉大模型技术,实现离线环境精准物体识别,支持视频/图片文字描述及双向内容交互,应用于智慧安防场景。基于KM02X的高清带屏智能视觉方案具备2TOPS端侧算力,可本地运行人形/车型/宠物/客流/手势/包裹等多场景AI算法,音频方面支持多路麦克风阵列、声源定位、环境降噪及语音唤醒。

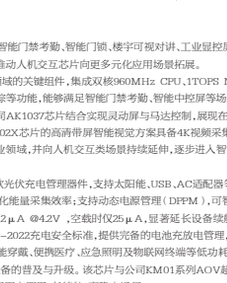
智能录音笔方案于2025年1月推向市场,助力客户实现国内首批对接豆包、通义千问、DeepSeek等大模型的端侧产品,具备毫秒级快启、80mW超低功耗控制能力。

生物识别考勤方案方面,AK2659芯片获阿里钉钉品牌采用,推出的智能算薪考勤机,实现人脸/掌静脉识别与自动考勤核算一体化,加速AI能力向中小企业普惠覆盖。智能陪伴应用相关,AI桌面机器人方案通过AK1037实现灵动屏与马达控制,结合AK2659实现手势识别与人形跟踪能力;AI桌面玩具、AI儿童拍学机等项目进入客户量产出货阶段。

行业应用相关,公司参与国家人工智能应用中试基地(能源电力方向)共建,探索电力巡检、能耗管理等工业物联网应用。

2.2主要经营模式

报告期内,公司的经营模式没有发生实质性变化。公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式,专注于AI硬件的SoC芯片及相关芯片的研发、设计、终测和销售环节。公司将芯片设计完成后将设计成果以GDSII文件形式交给晶圆制造企业;晶圆制造企业收到文件后首先完成光罩制作,再依据制作好的光罩通过光刻、蚀刻、掺杂等步骤在晶圆上制造裸晶(DIE);公司再委托芯片封装企业把晶圆上的裸晶切割并封装成芯片。公司取得封装后的芯片后将对其终测,并将通过测试的芯片销售给客户,获得收入、现金流和利润。公司的经营模式具体如下:



基于行业惯例、自身技术研发实力、资金规模等因素,公司选择“Fabless+芯片终测”经营模式。公司的经营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的,能够较好地满足下游客户需求,符合行业特点。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为AI硬件SoC芯片的研发、设计、终测和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520),细分行业为芯片设计行业;根据证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》(2024年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1 新一代信息技术产业—1.3 新兴软件和新型信息技术服务—1.3.4 新型信息技术服务(6520集成电路设计)”;根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,公司所属的集成电路设计行业属于鼓励类产业,公司主要产品属于新一代信息技术产业下电子核心产业中的集成电路芯片产品;公司主要从事赋能AI硬件的AI SoC芯片及相关芯片的研发、设计,属于国家重点支持的领域。

SoC芯片的研发与制造是一个高度跨学科、多技术融合的复杂工程,其核心壁垒不仅源于对芯片设计、工艺制程、系统集成等领域的深厚技术积累,更依赖精密的工艺管控与高效的跨团队协作。随着技术迭代加速,这一领域的门槛持续提升。具体而言,SoC芯片设计的复杂性表现在三个方面:其一,功能异构集成,需将CPU、DSP、存储控制器、I/O接口、电源管理等多元模块整合于单一芯片,这对IP核适配与系统级集成能力提出了严苛要求;其二,软硬协同设计,需通过软硬件联合开发确保软件栈与定制化硬件平台的高效适配;其三,全链路验证体系,必须经过逻辑验证、功能验证、性能验证、功耗验证等严格测试环节,以确保最终产品性能达标并满足市场需求。此外,针对芯片功能测试与故障诊断,还需构建专用的检测方案以保障各模块运行可靠性。由于SoC芯片研发涉及的研发资源投入(涵盖人力、硬件及时间成本)大,其全流程需历经市场调研、设计、流片、验证/测试等关键环节。这一系统化研发路径最终保障了芯片的高可靠性、高性能及市场竞争力。

AI SoC 芯片的核心技术壁垒体现在架构、工艺、IP、软件、生态与供应链的全方位系统性竞争,本质是在PPA(性能 / 功耗 / 面积)与成本、可靠性、兼容性之间实现极致平衡。芯片内部需实现 CPU、GPU、NPU、DSP、ISP、Codec 等多模块低延迟、高带宽协同,对任务调度与内存一致性提出极高要求。NPU、GPU、ISP 等关键 IP 自研周期长、投入大,通常需要 5-10 年持续积累。端侧 AI SoC 要在数瓦功耗内实现数十 TOPS 算力,对动态电压频率调节、电源域隔离、热节流等设计精度要求严苛。模型层面需兼容 CNN、Transformer 及多模态大模型,并持续适配 GPT、Stable Diffusion 等前沿算法迭代。同时要支持 Linux、Android、GNX 等操作系统,提供完善的 SDK、API 与调试工具,构建完整开发环境。综上,AI SoC 是架构创新、工艺极限、IP自主、软件生态与供应链安全的综合较量,单一环节的突破难以构建可持续的核心竞争力。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、知识产权示范企业创建对象及优势企业。公司芯片已进入ROKU、TP-LINK、小米、涂鸦智能、中国移动、Keep、安克创新、范式智能、螨基科技、安居宝、厦门立林、宁波存力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛、亚萨合莱、乐橙等知名客户供应链。随着产品系列的不断丰富,公司产品与客户的粘性也日益增强,有利于进一步客户渗透和新产品的开拓。

基于多个核心技术的积累和突破,报告期内公司取得多项荣誉或资质,主要为:

2025年1月,收到广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于印发第23批省级企业技术中心认定名单的通知》(粤工信创新函〔2024〕50号),公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。这是对公司技术水平、研发能力、创新能力及综合实力等多方面的又一次认可及肯定。

2025年3月,收到广州市人力资源和社会保障局转发的全国博士后管委会办公室下发的博管办〔2025〕42号文件,公司获批设立博士后科研工作站分站。获批设立博士后科研工作分站,肯定了公司在高层次人才培养平台建设方面取得的实质性突破,充分展示了公司在芯片设计领域的影响力。

2025年7月,第五届中国集成电路设计创新大会暨IC应用生态展(2025ICDIA创芯展)在苏州金鸡湖国际会议中心隆重举办。公司孔明系列之KM01N芯片从参评的102家企业的141款前沿芯片产品中脱颖而出,斩获2025中国创新IC“强芯领航奖”。这是安凯微连续两年在该类评选中获奖,也是公司带算力芯片再次获得行业认可。2024年,安凯微的AK3918Av100曾荣获“优秀产品奖”。

2025年12月,2025第一财经资本年会在上海浦东陆家嘴国际会议中心举行,公司获评2025第一财经资本市场价值调研“年度创新力企业”。该评选采用多维度综合评价体系,覆盖治理力、抗风险力、创新力、竞争力、影响力、回报力等多个方面,旨在发掘真正具备长期价值的创新企业。在半导体行业周期波动、公司短期业绩承压的背景下,获得来自权威财经媒体的奖项,是对公司内在创新价值和长期发展潜力的有力肯定。

2025年12月,在2026半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上,公司凭借在RISC-V技术领域的创新能力和产业化落地表现,荣膺“年度RISC-V技术创新奖”。该奖项旨在表彰对RISC-V生态建设与技术创新作出突出贡献的企业与机构。在新型算力需求持续增长的背景下,RISC-V架构正迎来从技术积累到产业爆发的关键阶段,该奖项不仅是对公司长期以来在RISC-V领域持续投入、创新实力及产业化成果的高度肯定,更凸显了公司在推动开源架构落地与应用拓展方面的行业引领作用。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1)顶层设计,促进新质生产力发展

当前全球科技竞争日趋激烈,发展新质生产力成为重塑国际分工格局、推动经济高质量发展的核心路径。2026年全国两会政府工作报告明确提出,以高水平科技自立自强为战略支撑,深化拓展“人工智能+”行动,打造智能经济新形态,将集成电路列为新兴支柱产业首位,全链条推进集成电路等领域关键核心技术攻关。在此背景下,新一代信息技术、人工智能、智能装备、物联网等战略性新兴产业迎来政策与市场双重机遇,国家以顶层设计、产业创新工程、场景开放与金融赋能协同发力,加速生产工具智能化、高效化、低碳化转型,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。伴随核心技术自主可控、本土创新人才集聚、企业国际化布局三大机遇叠加,我国科技企业正从产业链补位、国产替代迈向全球竞争新赛道。公司紧扣国家战略方向,聚焦智能硬件与智能体核心赛道,深耕赋能AI硬件的AI SoC芯片自主研发,主动融入新一轮科技革命与产业变革,以硬核技术底座支撑智能经济发展。

2)从智能硬件到智能体,AI驱动产业升级

人工智能正加速从单点技术应用向系统性产业底座演进。2026年政府工作报告明确提出“打造智能经济新形态”,将“促进新一代智能终端和智能体加快推广”作为重点方向。在政策引导下,云边端协同技术已从概念走向规模化落地:云端承载大模型训练,边缘侧实现低延迟推理,终端芯片支撑轻量化模型部署,三者协同构建起“云上训练-边缘推理-终端执行”的完整链路。与此同时,“智能体”正成为产业焦点,从单一对话助手向跨系统、跨终端的任务执行者演进,碎片化生态正加速走向互联互通。

技术层面,通用视觉大模型的突破使智能设备具备开放世界的感知能力。以“数字员工”为代表的多重任务智能体,已在办公、客服、工业控制等场景中实现降本增效。随着算力成本持续下降、模型部署工具链日趋成熟,智能体正从实验室走向规模化应用。在绿色算力与产业生态双重支撑下,行业级“智能体大脑”加速落地,人机协同从辅助决策向自主执行迈进,产业发展的技术路径与商业模式已日渐清晰。

市场层面,具备智能分析能力、边缘推理能力、支持端侧和边缘AI场景的芯片需求日益迫切,应用场景从智能家居、智慧安防向智能穿戴、智慧办公、AI眼镜、智能机器人等新兴领域加速渗透,据IDC统计,2025 年中国智能眼镜市场出货量同比增长87.1%,AI手机、AI PC等终端均实现高速增长。智能家居设备市场持续扩容,全屋智能场景逐渐取代单一智能产品,具身智能领域亦呈现加速态势。智能硬件和智能体市场持续扩容,为国产AI SoC芯片设计企业带来了明确的市场空间与发展机遇。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,638,336,764.95	1,664,581,269.57	-1.58	1,669,203,783.80
归属于上市公司股东的净资产	1,291,921,626.77	1,440,988,086.47	-10.35	1,531,475,721.53
营业收入	536,966,206.33	527,091,911.86	1.87	572,528,232.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	532,824,580.11	522,698,368.41	1.96	567,749,857.65
利润总额	-136,081,834.62	-55,084,709.94	不适用	18,780,182.50
归属于上市公司股东的净利润	-140,360,609.45	-56,768,164.61	不适用	26,843,386.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,100,197.86	-62,394,165.03	不适用	7,377,420.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,036,214.51	-59,988,874.81	不适用	18,246,724.87
加权平均净资产收益率(%)	-10.29	-3.81	减少6.48个百分点	2.54
基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.15	不适用	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.15	不适用	0.08
研发投入占营业收入的比例(%)	28.16	25.24	增加2.92个百分点	19.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	101,848,794.28	132,468,287.57	116,524,301.07	186,123,843.41
归属于上市公司股东的净利润	-22,102,290.63	-27,148,334.67	-32,989,496.70	-58,111,387.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,104,204.41	-27,223,482.89	-34,873,568.18	-59,898,942.58
经营活动产生的现金流量净额	-61,168,351.29	4,593,287.92	-280,369.11	45,819,207.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,116
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,721
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安凯技术公司	0	61,382,160	15.66	61,382,160	无	0	境外法人
浙江武义凯隆达电子科技有限公司	0	28,420,840	7.25	28,420,840	无	0	境内非国有法人
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	0	25,015,760	6.38	25,015,760	无	0	境外法人
HU NORMAN SHENGFA 胡胜发(以下简称“胡胜发”)	0	18,942,000	4.83	18,942,000	无	0	境外自然人
广州科技金融创新投资控股有限公司	0	17,247,160	4.40	17,247,160	无	0	国有法人
广东富成创业投资有限公司	0	12,576,619	3.21	0	无	0	境内非国有法人
武义弗丰投资有限公司	0	6,798,960	1.73	0	无	0	境内非国有法人
广州凯安计算机科技有限公司	0	5,141,640	1.31	0	无	0	境内非国有法人
广东粤财基金管理有限公司-广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-763,636	3,818,184	0.97	0	无	0	其他
广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)	0	3,531,920	0.90	3,531,920	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			注1:胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术公司、浙江武义凯隆达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司和广州凯驰投资合伙企业(有限合伙),合计控制公司25.95%股份的表决权。 注2:公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

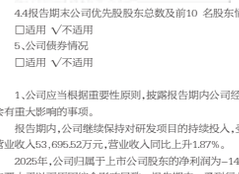
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权限制增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	安凯技术	61,382,160	0	61,382,160	15.66	0	无
2	武义凯隆达	28,420,840	0	28,420,840	7.25	0	无
3	PRIMROSE CAPITAL LIMITED	25,015,760	0	25,015,760	6.38	0	无
4	胡胜发	18,942,000	0	18,942,000	4.83	0	无
5	科金控投	17,247,160	0	17,247,160	4.40	0	无
6	富成投资	12,576,619	0	12,576,619	3.21	0	无
7	弗丰投资	6,798,960	0	6,798,960	1.73	0	无
8	凯安科技	5,141,640	0	5,141,640	1.31	0	无
9	广东半导体基金	3,818,184	0	3,818,184	0.97	-763,636	无
10	凯驰投资	3,531,920	0	3,531,920	0.90	0	无
合计	/	182,875,243	0	182,875,243	/	/	/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司继续保持对研发项目的持续投入,受益于市场需求持续及部分新产品顺利导入市场,实现了芯片出货量的增长,实现营业收入53,695.52万元,营业收入同比上升1.87%。

2025年,公司归属于上市公司股东的净利润为-14,035.06万元,较去年同期减少8,358.24万元,同比减少147.23%。公司净利润下降主要由于以下原因综合影响导致:报告期内,受到行业市场竞争持续的影响,部分产品线价格持续承压,加2025年第四季度有所缓和,2025年全年毛利率同比下滑;公司于2025年新增的8个光罩项目逐步进入量产阶段,继续保持较高的研发投入,研发费用增加;受美元汇率波动及现金管理形成的利息收入减少的影响,财务费用增加;公司基于审慎性原则,对于出现减值迹象的资产进行测试并计提减值损失,产减值损失增加。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-013

广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》,同意公司向银行在融资总额度不超过6.8亿元人民币(含本数)范围内申请融资及综合授信等事宜,期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东会审议通过之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体如下:

一、向银行申请授信额度的基本情况

鉴于,近年来公司业务持续增长,为满足公司(含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司、艾立微科技有限公司和控股子公司思澈科技(南京)有限公司及其全资子公司)业务发展的资金需求,公司拟向银行在融资总额度不超过 6.8 亿元人民币(含本数)范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以签订的相关协议为准。

二、公司接受担保的情况

公司主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFA HU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币(含本数)范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保(根据银行审批要求执行,且具体担保行为的发生、担保金额、担保期限以NORMAN SHENGFA HU实际与银行签订的相关协议为准)。前述担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

三、业务期限

上述授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东会审议通过之日止。

四、实施授信融资的授权情况

为满足公司运营资金实际